



boschman
advanced packaging technology

SINTERSTAR 系列

银烧结技术



Boschman 是提供高度创新封装解决方案的一站式服务提供商。

Boschman 是一家以解决方案为导向的荷兰高科技公司，专注于提供先进的封装解决方案。我们秉持独特的一站式服务理念，从构想到工业化，针对所有封装业务为客户提供一站式接洽点。这种方式可确保所有工艺得到仔细监控和集成，从而创造最有效且高效的封装解决方案，帮助客户尽可能缩短产品上市时间。

我们的行业应用重点

我们正在为以下行业的客户提供优质服务：

- 汽车
- 医疗
- 航空航天
- 移动
- 工业 & 可再生能源

我们的应用领域



微机电系统和传感器



2.5D/3D 封装



高功率模块和封装



智能卡



光学封装



我们的产品

关于银烧结技术

银烧结是一种经过验证的芯片粘接技术，可确保无空隙和高强度键合，并具有高导热性和导电性。这种技术良品率高，十分可靠。Boschman 是银烧结服务和设备的市场领导者。我们针对许多客户的不同应用提供各种解决方案，并累积了丰富的知识和经验。我们利用独特的动态压头技术，提供内部烧结工具的设计、制造和测试服务。我们能按要求提供任何行业解决方案，包括夹具烧结等。

Boschman 提供两种银烧结解决方案：对于研发、原型制作和小批量生产，我们提供半自动 Sinterstar Innovate 系列。而对于高效、高质量的大中批量生产，Sinterstar Auto 和 Inline 系列是最佳选择。我们的系统能够烧结各种不同的器件，包括 LED、电源器件夹/散热器组件、太阳能 (CVP) 电池、定制电源模块等。



Sinterstar Innovate-F-XL

这是最通用的半自动烧结系统，适用于所有环保无铅的芯片粘接技术。该系统非常适合研发和小批量生产，良品率高，十分可靠。



Sinterstar Innovate-F-XL-WL

适用于晶圆背面贴膜的通用半自动烧结系统



我们的产品

Innovate 的主要特性:

- 高达 300°C 的精确温度控制
- 350 x 270 mm 的有效烧结面积
- 夹具烧结功能
- 在整个产品处理和烧结制程中集成 N₂ 保护
- 为原型制作环境提供通用工具
- 开发客户特定的系统改进功能
- 能够集成客户特定的工艺，如液压或软加工
- 充分特征化的工艺和处理参数
- 闭环精确压力控制和监测
- 仅在需要的区域施加压力
- 获得专利的动态压头技术 (DIT) 可确保为多种芯片应用提供相等的压力
- 使用最高密度工具，间隙低至 400 μm



Sinterstar Inline-F-XL

Inline-F-XL 是一款经济型烧结系统。该系统有两个外部装夹系统，用于在烧结制程区域的自动上下料。



Sinterstar Inline-F-XL-HC

全自动 Inline-F-XL-HC 可整合到自动化装配线中。该系统配备预热和冷却工位。



我们的产品



Sinterstar Auto-F-XL-HC

全自动的独立型 Auto-F-XL-HC 可完成从上料盒输入到下料盒输出的整个过程。该系统配备预热和冷却工位。

Inline/Auto 的主要特性：

- Sinterstar Innovate 系列的所有规格和价值
- 可集成预热和冷却单元
- 集成晶片盒处理器
- 具有大量系统选项，能够提高生产效率、增强工艺控制并保证最佳质量
- 工具使用寿命极长，因而运行成本非常低
- 采用 Secs-Gem 通信程序包，能够与客户的 MES 系统、产品可追溯系统和配方管理系统对接
- 提供许多标准选项，能够实现快速换型、提高生产率并保证质量

“尺寸更小、性能更好、成本更低，
为您的产品提供最好的封装！”



package
development



assembly
services



equipment

Boschman | 先进封装技术

Stenograaf 3 6921 EX Duiven 电话 +31 26 319 4900 电子邮箱 info@boschman.nl

www.boschman.nl